

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年7月23日(23.07.2020)



(10) 国際公開番号

WO 2020/148968 A1

(51) 国際特許分類:
CIID 1/62 (2006.01) *CIID 7/50* (2006.01)
CIID 7/32 (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)
CIID 7/34 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2019/042936

(22) 国際出願日: 2019年10月31日(31.10.2019)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2019-004292 2019年1月15日(15.01.2019) JP

(71) 出願人: 昭和電工株式会社 (SHOWA DENKO K.K.) [JP/JP]; 〒1058518 東京都港区芝大門 1丁目1番3号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 中崎 晋 (NAKAZAKI, Susumu); 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目1番3号 昭和電工株式会社内 Tokyo (JP). 宮原 邦明 (MIYAHARA, Kuniaki); 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目1番3号 昭和電工株式会社内 Tokyo (JP). 福世 知行 (FUKUYO, Tomoyuki); 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目1番3号 昭和電工株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 青木 篤, 外 (AOKI, Atsushi et al.); 〒1058423 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,

BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) **Title:** DECOMPOSING/CLEANING COMPOSITION, METHOD FOR CLEANING ADHESIVE POLYMER, AND METHOD FOR PRODUCING DEVICE WAFER

(54) 発明の名称: 分解洗浄組成物、接着性ポリマーの洗浄方法、及びデバイスウェハの製造方法

(57) **Abstract:** Provided is a decomposing/cleaning composition for an adhesive polymer having a high etching rate and suppressed infiltration into a contact interface between a substrate such as a device wafer and an adhesive layer such as a fixing tape. The decomposing/cleaning composition of one embodiment is a decomposing/cleaning composition for an adhesive polymer containing a quaternary alkylammonium fluoride or a quaternary alkylammonium fluoride hydrate and an aprotic solvent, wherein the aprotic solvent contains (A) an N-substituted amide compound having no active hydrogens on the nitrogen atoms and (B) at least one organic sulfur oxide selected from the group consisting of sulfoxide compounds and sulfone compounds.

(57) 要約: 高いエッチング速度を有しており、デバイスウェハなどの基材と固定テープなどの粘着層の接触界面への浸入が抑制された、接着性ポリマーの分解洗浄組成物が提供される。一実施態様の分解洗浄組成物は、第四級フッ化アルキルアンモニウム又は第四級フッ化アルキルアンモニウムの水和物と、非プロトン性溶媒とを含む、接着性ポリマーの分解洗浄組成物であって、非プロトン性溶媒が、(A) 窒素原子上に活性水素を有さないN-置換アミド化合物、及び(B) スルホキシド化合物及びスルホン化合物からなる群より選択される少なくとも1種の有機硫黄酸化物を含む。

WO 2020/148968 A1